

キヤノンが「SEMICON Japan 2025」に出展 半導体製造の多様化に対応する装置や環境配慮の取り組みを紹介

キヤノン、キヤノンアネルパ、キヤノンマシナリーの 3 社は、2025 年 12 月 17 日（水）から 19 日（金）まで、東京ビッグサイトで開催される半導体産業の国際展示会「SEMICON Japan 2025」に出展します。



キヤノンブース（イメージ）

半導体産業は、生成 AI などの用途拡大に伴い、製造プロセスのさらなる進化が求められています。これにより、前工程での微細な回路パターン形成技術や、後工程での多機能・高密度なパッケージング技術への関心が高まっています。キヤノンブースでは、ナノインプリント技術を用いた微細化と省電力化を実現する装置や、先端パッケージングに対応する後工程向けの装置など、次世代半導体製造を支えるさまざまな技術と製品を出展します。

■ 前工程から後工程まで対応するキヤノンの半導体製造装置

ナノインプリント技術を用い、低コストで微細な回路パターンを形成できる半導体製造装置「FPA-1200NZ2C」（2023 年 10 月発売）や、先端パッケージングに対応する後工程向け露光装置「FPA-5520iV LF2 オプション」（2023 年 1 月発売）など、幅広い製品を紹介します。また、キヤノンの MR（Mixed Reality：複合現実）システム「MREAL（エムリアル）」を使用し、半導体露光装置内部の露光動作をご覧いただけます。

■ 半導体製造に貢献するキヤノンのインダストリアルグループの多様な製品群

キヤノンアネルパは、「iF デザインアワード 2025（プロダクト分野）」で最高位の金賞に選出されるなど複数のデザイン賞を受賞した、幅広い用途の成膜工程に対応する装置シリーズ「Adastra（アダストラ）」（2024 年 10 月発売）のモックアップを展示するほか、ウエハーを接合する原子拡散接合装置「BC7300」（2023 年 6 月発売）をパネルで紹介합니다。またキヤノンマシナリーは、12 インチウエハー対応のダイボンダー「BESTEM-D610」（2025 年 1 月発売）の実機を使ったデモを行うなど、半導体デバイスやパッケージ基板製造に欠かすことのできない、インダストリアルグループの多様な製品ラインアップを展示します。

■ 環境に配慮した半導体露光装置の取り組み

キヤノンは、製品ライフサイクル全体での CO₂排出量を 2050 年までにネットゼロとすることを目指し、環境負荷低減に寄与する技術を積極的に導入しています。部品の刷新や仮想化技術を活用した装置の長寿命化や、脱炭素・脱水銀に貢献する UV-LED 露光オプション対応など、キヤノンの半導体露光装置における環境配慮の取り組みをパネルで紹介します。

〈SEMICON Japan 2025 開催概要〉

会 期：2025 年 12 月 17 日（水）～19 日（金）10：00～17：00

会 場：東京ビッグサイト

入 場 料：無料（要事前登録）<https://www.semiconjapan.org/jp/about/pricing-and-register>

キャノンブース：南展示棟 1 階

〈サステナビリティサイト「インダストリアルグループの取り組み」〉

<https://global.canon/ja/sustainability/environment/business/industrial/>

〈品質サイト「半導体露光装置」〉

<https://global.canon/ja/quality/story/2025-semicon.html>